



INTEK-PLUS
Integrated Measurement System



Disclaimer

본 자료에 포함된 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국의 기업회계기준에 따라 본사기준으로 작성되었습니다.

본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', (E) 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.



Contents

Chapter A. Corporate Overview

Chapter B. Business Strategy

A

Corporate Overview

01_ 2019 review

02_ 기술역량

03_ 핵심기술

04_ 사업분야

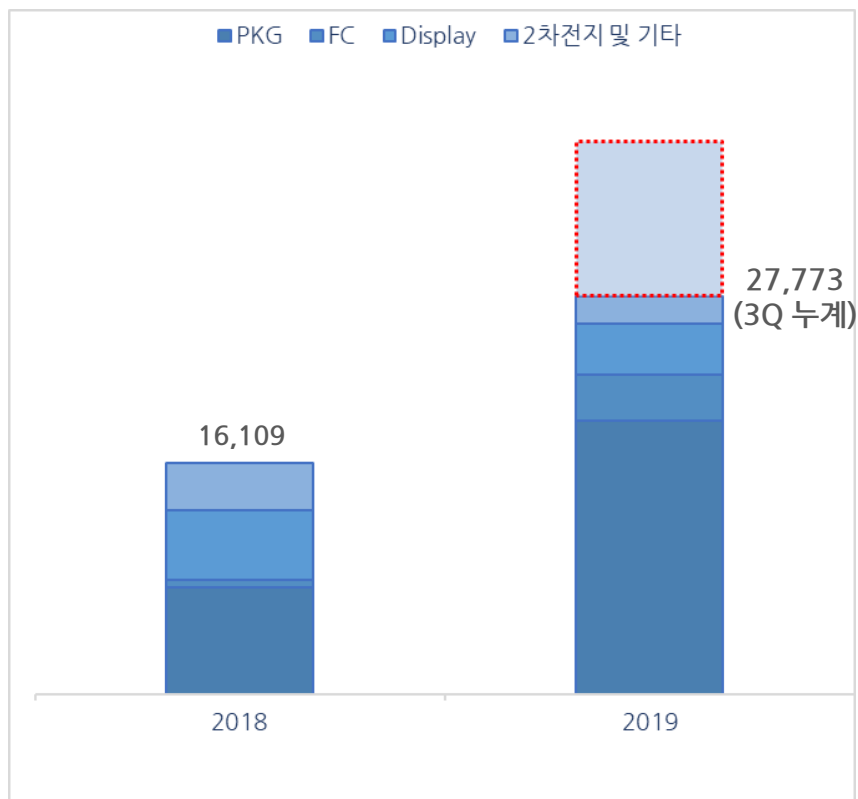
05_ 회사개요

턴어라운드 2019년

글로벌 메이저 반도체 업체에 외관검사장비 독점 납품 시작

중국 최대 디스플레이 업체의 Flexible Display 생산라인용 검사장비 공급

2차전지 검사 장비 수주 시작 (매출 인식은 2020년으로 연기)



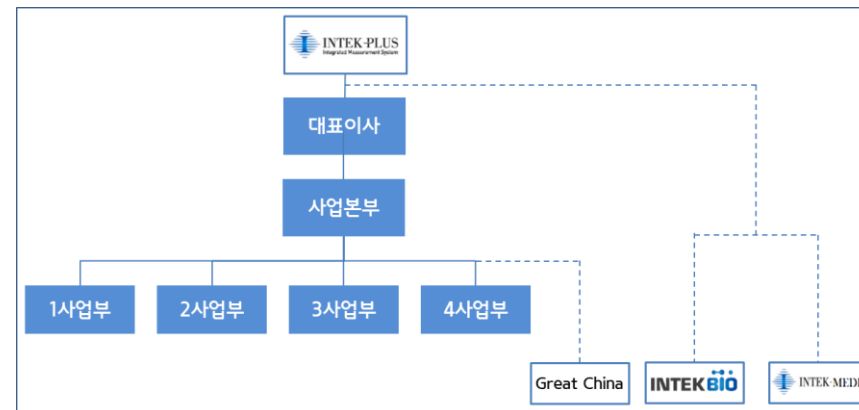
(단위:백만원)

구분	3Q19실적	19.수주
반도체 PKG 분야	19,038	28,510
Flip-Chip 분야	3,256	5,134
Display 분야	3,525	7,765
2차전지 및 기타	1,954	6,529
계	27,773	47,938

· 일반현황

회사명	(주) 인텍플러스
사업영역	2D/3D 외관검사장비
설립일	1995년 10월(상장 2011년 1월)
자본금	65.8억원
임직원수	187명
소재지	대전시 유성구 테크노 2로 263

· 조직도



· 임원 구성

CEO	이 상 윤
학력	· KAIST 기계공학과 박사 · 서울대 기계설계 학사/석사
경력	· 한국과학기술원 위촉연구원 · (주)인텍플러스 연구소장 · 現. (주)인텍플러스 대표이사

· 주요 임원진

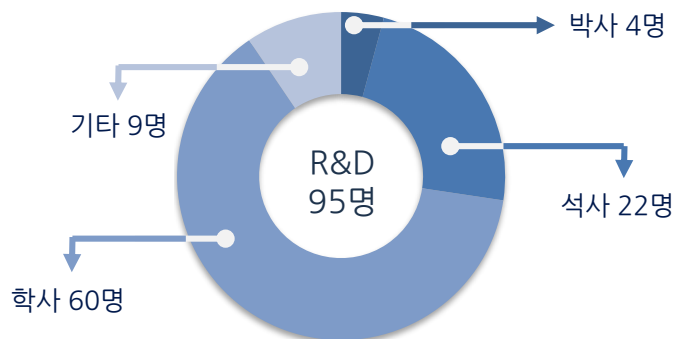
최 이 배	· KAIST 기계공학과 박사 · 現. (주)인텍플러스 사장
강 민 구	· KAIST 기계공학과 박사 · 現. (주)인텍플러스 상무
유 승 봉	· KAIST 기계공학과 박사 · 現. (주)인텍플러스 상무보

우수한 R&D 인력 및 핵심 특허 보유

· 인력구성

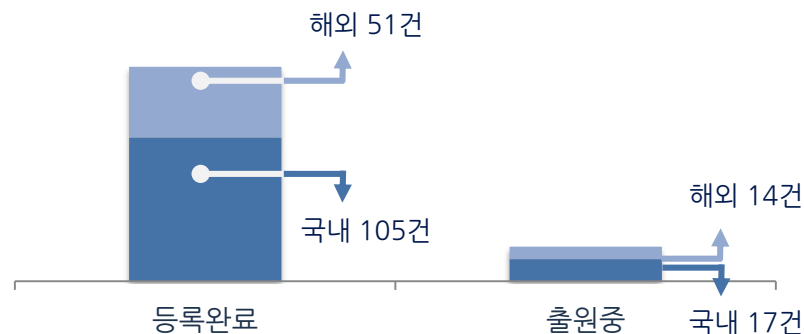


· R&D 인력현황



· 특허현황

156건 특허 보유, 31건 출원 중

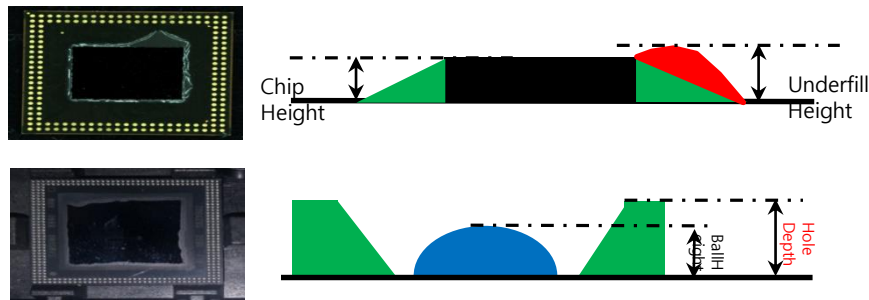


· 주요 핵심 특허

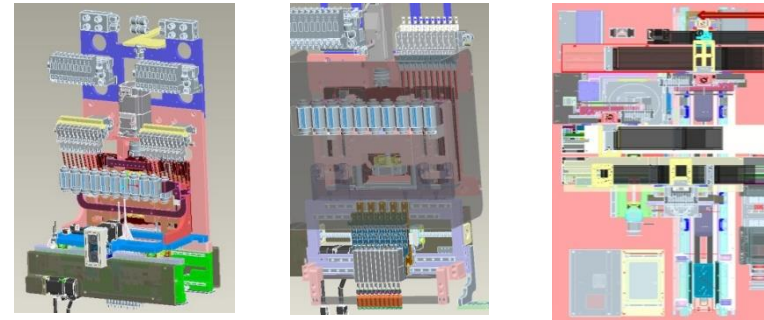
- 표면 형상 측정 시스템 및 그를 이용한 측정 방법(WSI+3D)
- 광학식 2차원 및 3차원 형상 측정 시스템(Moire+3D)
- 3차원 형상 측정장치 및 측정방법
- 영상 데이터 고속 송/수신 방법 및 영상 장치

외관검사장비 구현을 위한 원천기술

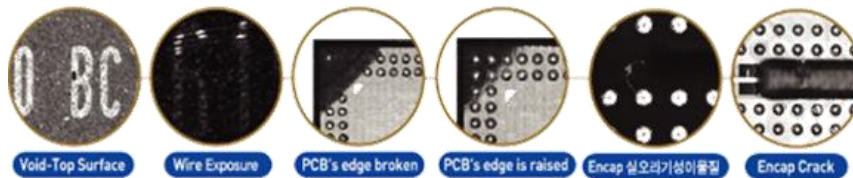
· 고속 3D 검사기술



· 자동화 장비 설계 및 제작 기술



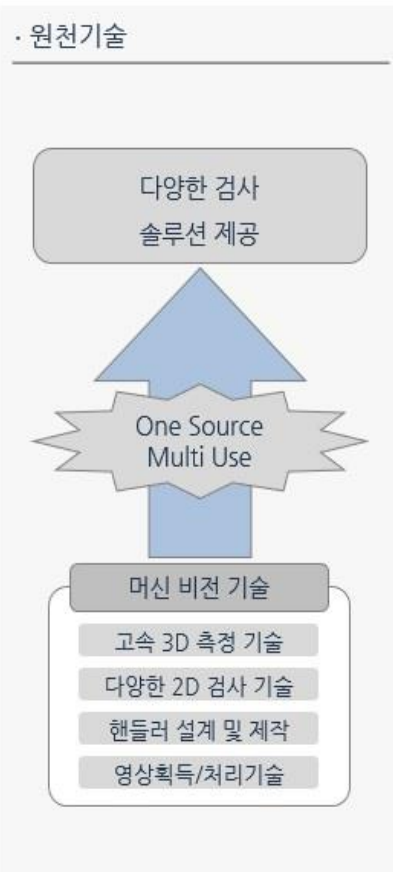
· 2D 검사기술



· 고속 영상 획득 및 처리 기술



머신 비전 기술을 바탕으로 다양한 분야의 검사 솔루션 제공



 B

Business Area

01_ 반도체 PKG 분야 (1사업부)

02_ MID - END 분야 (2사업부)

03_ Display 분야 (3사업부)

04_ 2차전지 및 검사자동화 분야 (4사업부)

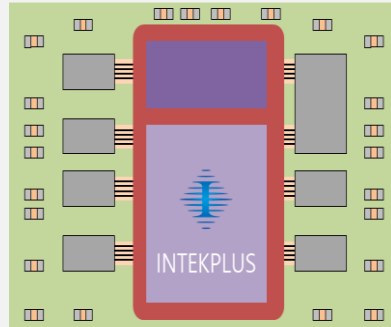
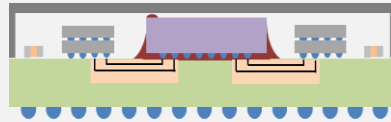
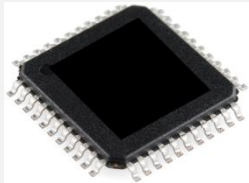
05_ 의료분야 (계열사)

06_ 중장기 성장 전략

새로운 강자

새로운 트렌드의 반도체 칩(PKG)에 필수적인 LFF 검사 및 6면 검사 원천기술 보유
미국 메이저 고객사 신규 진입을 기반으로 반도체 칩 외관검사 점유율 확대 진행중

Advanced PKG - Heterogenous Integration



자료:하나금융투자, 인텍플러스

새로운 트렌드에 필요한 검사 솔루션 확보

- Large Form Factor 검사 기술
- 6면 검사 기술



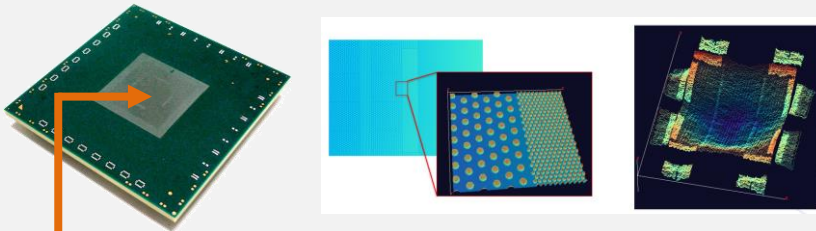
메이저 반도체 업체 중심의 점유율 확대 전략

- 미국 메이저 업체 PKG 검사장비 단독 공급
- 국내 양대 메이저 업체 장비 데모 진행 중
- 대만 메이저 업체 데모 준비 중
- 중국 메이저 업체 데모 성공, 수주 시작

HPC, 5G 시장 확대

HPC, 5G용 Advanced Package 기술 적용의 확대

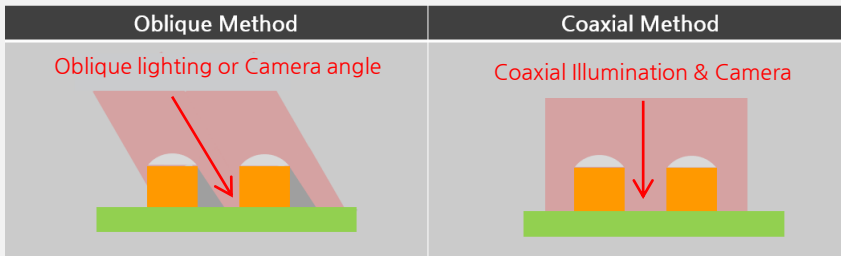
FC-BGA Bump 외관검사



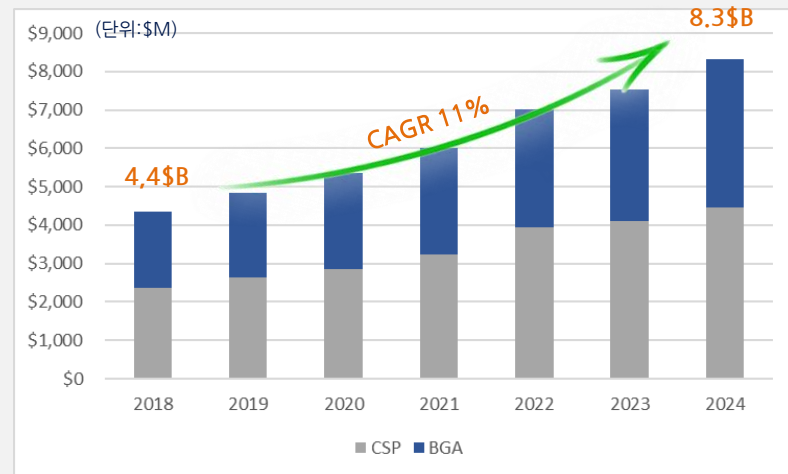
C4 Area

- Bump Height/ Coplanarity
- Chip Attach-area Warpage
- Bump Diameter/ offset
- Thickness Variation
- Bump damage
- Bridge/ Missing bump
- Scratch

Bump 3D Inspection Solutions



Advanced IC Substrate 시장 전망



- Status of Advanced Substrates 2019 (Yole Developpement)

내년도 수요 증가 예상

- 미국 메이저 업체의 신규 공정 본격 양산 시작
- 국내 메이저 업체의 Fo-PLP 본격 양산 시작
- 중국 통신업체를 중심으로 한 5G용 Advanced Package

Flexible & Foldable OLED

국내외 Flexible OLED 공정에 신규로 도입된 Cell 최종단 외관검사장비

Flexible OLED 적용 스마트폰 확대 및 폴더블 스마트폰 양산에 따른 국내외 디스플레이 업체 투자 수혜 예정

플렉서블 OLED 셀 외관 검사장비 솔루션 단독 보유



국내외 OLED 투자 이슈

구분		18년 이전	19년	20년	21년	21년 이후
SDC	A3	135K				
	A4	30K				
	A5			?		
BOE	B7 (청두)	48K				
	B11 (면양)		48K			
	B12 (충칭)			48K		
	B15 (푸저우)					48K

註 ① 자료출처 : 한국투자증권, 한화투자증권, 언론자료

2차전지 수주 시작

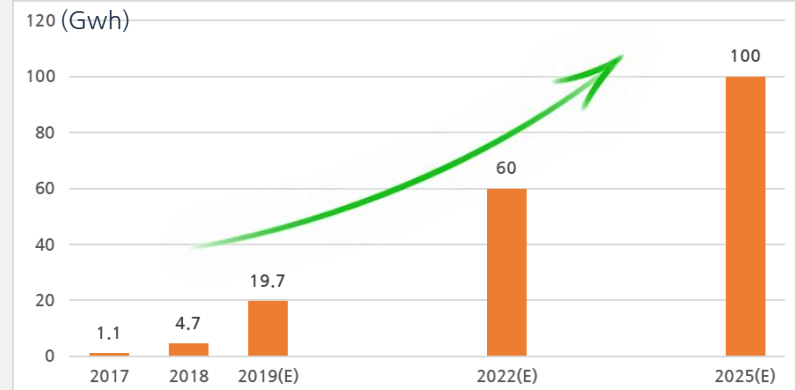
국내 메이저 2차전지 제조사 밸류 체인 진입

내년도 본격 수주 예상

파우치타입 2차전지 검사장비 솔루션 확보



국내 메이저 2차전지 제조사 투자 계획



자료출처 : 키움증권 리서치

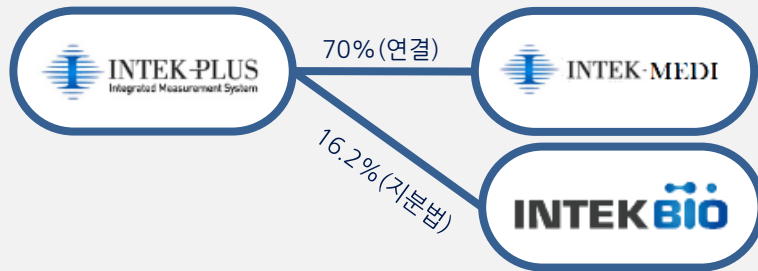
2차전지용 검사장비

- 자동차용 2차전지 셀외관검사기, 셀측정기 납품 중
- 주요 고객사 글로벌 투자 진행중
- 고객사 및 아이템 확대 진행중

의료분야 : 머신비전기술의 확장 영역

인텍플러스가 보유한 머신비전기술, 기계설계기술 및 관련 분야의 네트워크 활용으로 사업 다각화 추진
기술 사업화 참여 및 엔젤투자를 통한 신규 사업 리스크 관리

의료분야 사업진행 현황



인텍바이오



POCT (Vit.D, TST, PSA, TSH):

- 국내, 유럽 인허가 완료, 판매 시작
- 2020년 미국 FDA 인허가 완료 목표

HS ELISA: 협심증, 치매 개발 임상 진행중(서울대 병원)

인텍메디

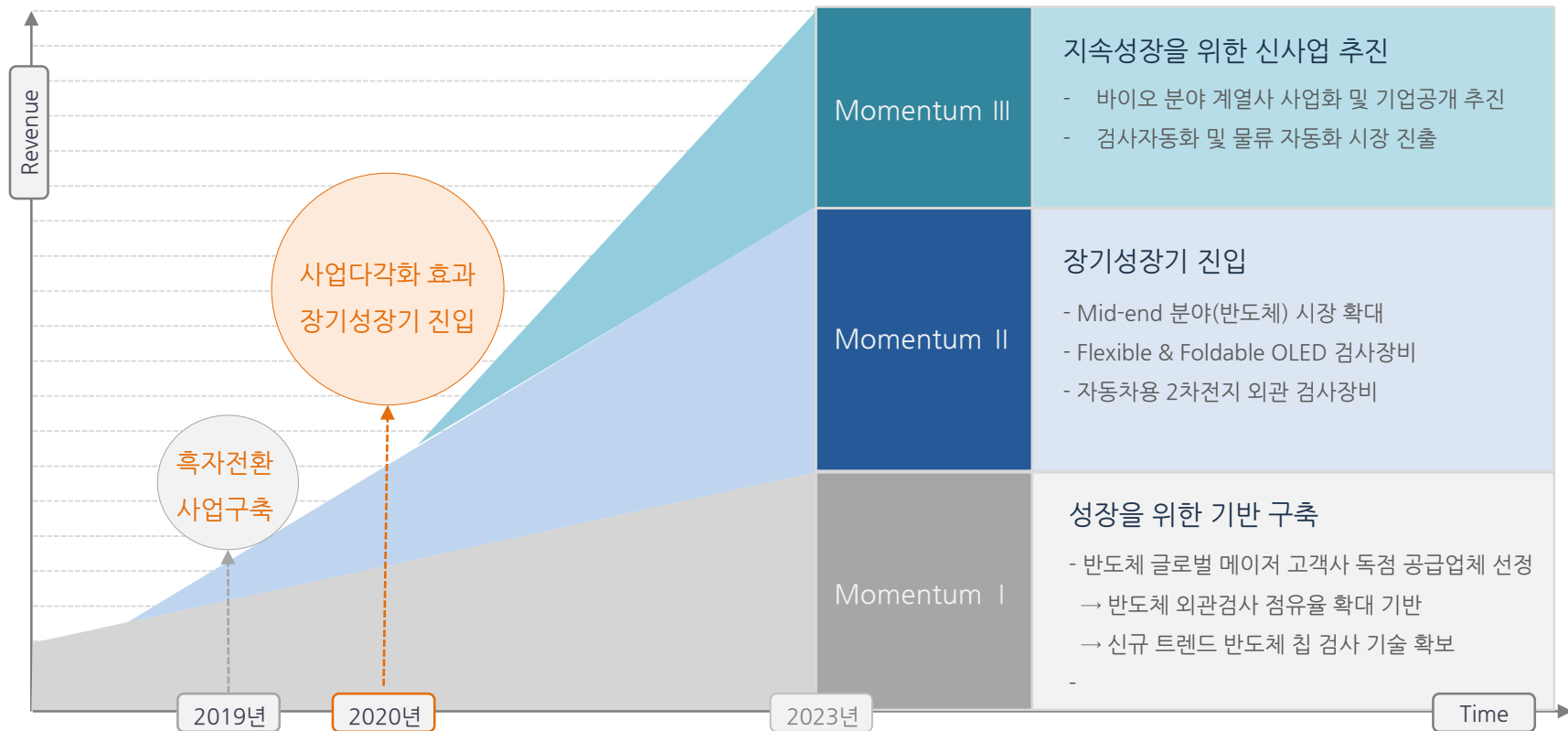


- 체외진단 리더기
- 복강경 절제기
- 형광수명현미경

중장기성장기 진입

반도체분야 에서 Flexible OLED 및 2차전지 분야로 사업 다각화 성공

데이터센터, 5G, 자율주행차, 전기자동차, 인공지능, Flexible 디스플레이 등 전방 산업의 장기적 성장 수혜 시작



THANK YOU

이 종목의 더 많은 IR정보 [확인하기](#)

IR GO 주주와 기업을 연결하고 응원합니다.